

接近开关
开关距离增加型

I30H017

订货号



- 切换距离增加
- 创新性 ASIC 技术
- 采用 weproTec，安装距离降低
- 集成错误指示器

独特的增强切换距离传感器，凭借坚固的结构、简单的安装方式和可靠的测量结果令客户信服。作用范围更大，无需更多类型的传感器，即使特殊应用也能轻松解决。由于采用 ASIC 和 wenglor weproTec，除多只传感器能在有限空间内无故障运行外，新一代产品还能够及时识别系统中的故障。

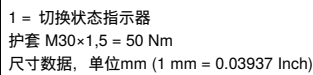
weproTec

技术数据

感应数据	
开关距离	35 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,00/0,42/0,39
装配类型	未齐平
装配A/B/C/D，单位为mm	55/82/105/35
装配B1，单位为mm	0...80
切换滞后	< 10 %
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 12 mA
切换频率	140 Hz
温度偏差	< 10 %
温度范围	-40...80 °C
切换输出端压降	< 1 V
切换输出端开关电流	150 mA
切换输出端剩余电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	CuZn，镀镍
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1；4针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3706,54 a
功能	
错误指示器	是
NPN 常开触点、PNP常闭触点	●
接线图编号	100
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	130

补充的产品

PNP-NPN转换BG2V1P-N-2M



符号注解

The image contains three technical drawings of a multi-layer printed circuit board (PCB) illustrating different types of vias:

- Top Drawing:** Shows a cross-section of a multi-layer PCB with a top layer, prepreg, and core. It features two types of vias:
 - Microvia:** A small hole drilled into the top layer, with dimensions A (diameter), B (annular ring width), C (plating thickness), and D (plating height).
 - Through-hole via:** A larger hole drilled through the entire board, with dimensions B (diameter) and C (plating thickness).
- Bottom Left Drawing:** Shows a cross-section of a microvia with a diameter of $1,5 \times \text{Sn}$, where Sn is the diameter of the drill bit.
- Bottom Right Drawing:** Shows a cross-section of a microvia with a diameter of $B1$, where B1 is the diameter of the drill bit.